

晶圆助焊剂WS-3401

简介

WS-3401晶圆助焊剂是半导体级的低黏度助焊剂，其配方专门为清除晶圆上焊点表面的氧化物而设计。在焊料本身表面张力的作用下，**WS-3401**能形成一致的半球形焊点，既不会损失焊料，也不会形成桥连。其良好的流变性使其可以用旋涂或者用喷涂的方法进行涂覆。

特点

- 溶于水
- 黏度适用于150-300mm的晶圆
- 多次回流/清洁后无残留
- 无卤素 - 无添加卤素
- 焊点形状均匀一致
- 适用于SnPb、无铅和高温焊接制程
- 不会侵蚀焊点下的金属化表面

属性

属性	数值	测试方法
助焊剂类型	M0	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.3.32 & 2.3.33)
颜色	琥珀色和褐色之间	肉眼观察
典型黏度	45 cst	Cannon-Fenske黏度计
典型酸值	68 mg KOH/g	滴定法
表面绝缘电阻 SIR (ohms)	合格 (>10 ⁸ : 7天后, 85°C、相对湿度85%)	J-STD-004 (IPC-TM-650: 2.6.3.3 IPC-B-24)
保质期	6个月 (0-25°C)	黏度变化/显微镜检查

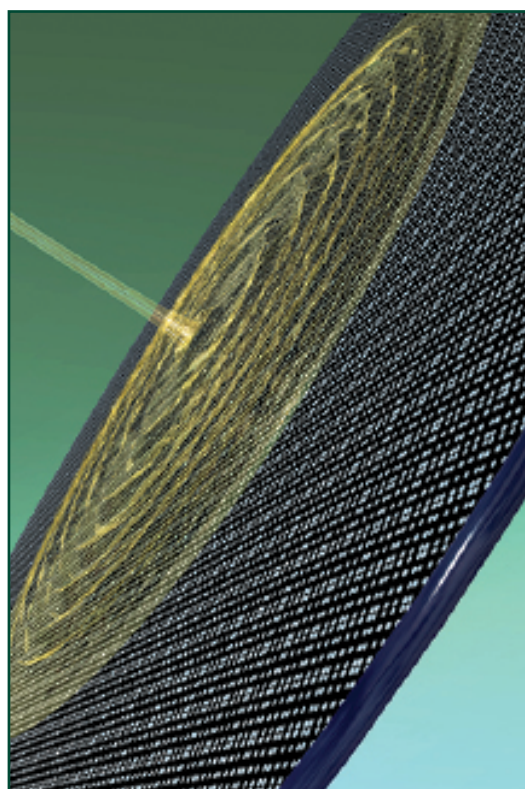
所有信息仅供参考，不作为订购产品的规格说明。

应用

WS-3401可用标准的喷涂或者旋涂技术涂覆。

旋涂：采取初始转速来保证液态助焊剂被均匀地涂布在晶圆上，然后根据具体应用采用15rpm到800rpm的转速。晶圆的尺寸、局部结构、间距和助焊剂应用都是能影响转速的变量。快速旋转被用于减小助焊剂的厚度和去除晶圆上过量的助焊剂。

喷涂：助焊剂储存罐中的助焊剂应足够持续供应8小时。罐内剩余的助焊剂如果存放时间过长可能会过期（室温下可在罐内存放8小时以上）。喷雾器需要经常清洗，从而有效地保证此助焊剂或其他助焊剂的纯净度。



安全说明书

如欲获取本产品的安全说明书，敬请访问：
<http://www.indium.com/sds>。

翻页 →

晶圆助焊剂WS-3401

包装

WS-3401按重量出售 (g)。包装规格通常为100克到3.7千克 (约1加仑)。其它特殊包装可应求提供。

清洗

WS-3401可用去离子水 (DI) 和添加了清洗剂的水溶液清洗。喷雾清洗的理想条件为：25°C (或更高) 温度下，用超过60psi的压力冲洗超过1分钟。

技术服务

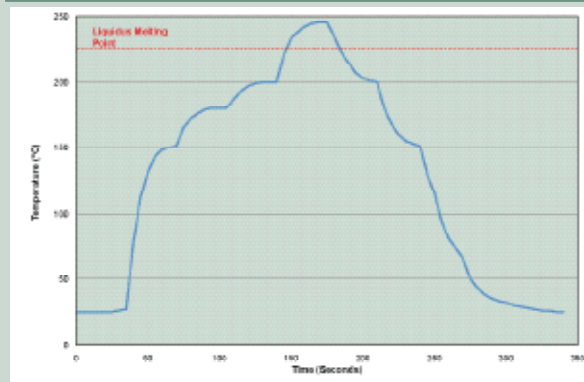
钢泰公司拥有经验丰富的国际工程师可为我们的客户提供深度技术协助。技术支持工程师深谙电子和半导体封装领域中材料科学应用的各个方面，其快速应答和随时提供现场技术支持的高品质服务设立了行业标杆。钢泰公司的技术支持工程师竭诚为您服务，将第一时间回应所有技术咨询。

储存

为了保证达到其最长的保质期，WS-3401应储存在0-25°C的环境中。不能在超过25°C的环境中储存超过4天，温度也绝对不能超过30°C。应至少提前4小时从冷藏环境中取出，使其在使用前达到室温。

回流

推荐的温度曲线



我们推荐使用上面的曲线作为300mm晶圆 (SnAg微型凸点) 的初始参考。然而针对不同应用，应对此曲线进行优化来满足特定需求。晶圆应在氮气气氛中回流。氧气最好低于10ppm，但是低于20ppm也可行 (但结果可能差强人意)。请注意，桥连或缺锡的现象可能出现在铜柱的细间距微型焊点 (<60微米) 上，而降低峰值温度可以减少此类故障的产生。

本产品说明书仅供参考，并不对所描述的性能做任何担保。具体质保信息请参见产品合同、发票或者发货单里的文字说明。除特别说明，钢泰公司的产品和解决方案均市场有售。

立即联络: china@indium.com

更多详情: www.indium.com

中国 +86 (0) 512 628 34900 • 亚洲 +65 6268 8678 • 欧洲 +44 (0) 1908 580400 • 美国 +1 315 853 4900

